

月度市场报告

8月份全球半导体销售额同比增长21.7%

2025年10月刊

新汉科技

仅供内部使用

目录

本月重点	3
原厂动态	4
行业趋势	7
安世专题报道	11
政策影响	14
最新财报	15
高风险物料预警	19

本月重点

1. ADI 11 月或涨价
2. Allegro 提前完成业绩目标
3. TI 计划到 2030 年实现 95%的自主生产
4. SEMI 报告称，未来三年全球 300mm 晶圆厂设备支出预计总计将达 3740 亿美元
5. 8 月份全球半导体销售额同比增长 21.7%
6. 多家原厂第三季度财务表现亮眼，SK 海力士营业利润首次突破 10 万亿大关
7. 安世专题报道

本报告每月发布一次，部分消息源自于我们供应商或客户的所见及所闻，部分消息来自于渠道直接或间接提供。本报告由新汉科技整理并做简单分析，并不代表新汉科技观点及立场，仅供参考与学习。网络消息繁杂，请大家注意甄别。

原厂动态

ADI 11 月或涨价

据代理商反馈，ADI 或在 11 月发布涨价函，受此影响，市场上部分代理商和渠道商已不接受订货，客户端的需求量也略有下降。目前 ADI 价格较高的集中在一些交期较长的物料上，如 ADXL355。

Allegro 提前完成业绩目标

Allegro 已完成 2025 年业绩目标，第四季度的汽车业务订单一直在增加，目前已增长 8%，订单已排到了 2026 年第一季度，主要集中在汽车和机器人领域。Allegro 的交期依旧很长，部分物料交期在 16-1 周，热门料号主要集中在电机控制和位置检测等领域，如 ACS780LLRTR-100B-T、A1104LLHLX-T、A3251LUA。

三星和 SK 海力士将内存价格上调 30%

根据科创日报消息，人工智能驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK 海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM 和 NAND 的价格涨幅将达 30%，以满足 AI 驱动的存储芯片需求，并提升第六代 HBM 的盈利能力。

Micron 本月价格涨幅最高达 60%

Micron 目前基本半个月调整一次价格，各产品线轮番涨价，涨幅在 30-50%，交期也普遍较长，基本在 14-18 周。有部分通用的 DDR3 256M 的型号涨幅在 60%左右。不过 Micron 后续业务发展较好的板块还是汽车领域。

瑞萨本月服务器需求激增

瑞萨本月服务器领域需求增加, 主要为 RAA 和 IDT 系列, 据说是因为其竞对的某个品牌无法满足客户需求, 导致客户转向瑞萨的产品。但由于需求的突然爆发, 导致 RAA 系列出现短缺情况, 部分型号面临断线, 交期也有原来的 12-14 周拉长到 22 周以上。

Skyworks 与 Qorvo 宣布合并, 打造 220 亿美元射频巨头

当地时间 10 月 28 日, 美国两大射频 (RF) 芯片巨头 Skyworks 和 Qorvo 共同宣布, 双方已达成最终的合并协议, 预计合并后的新公司价值约为 220 亿美元, 将成为一家总部位于美国的全球高性能射频、模拟和混合信号半导体领域的全球领导者。此次合并创建了一家创新的全球射频、模拟和功率技术公司, 可以为客户提供更高度集成、更完整的解决方案, 以及广泛的产品和技术。合并后的公司预计收入约为 77 亿美元。双方预计该交易将于 2027 年初完成。交易完成后, Skyworks 股东将拥有合并后公司约 63% 的股份, 而 Qorvo 股东将在完全稀释的基础上拥有约 37% 的股份。

铠侠 Q4 持续涨价, 产能缩紧

铠侠目前的产能只能满足 60% 的客户, 但价格一直在涨, 第四季度将持续涨价 5-15%。随着存储芯片产能逐步向计算卡、服务器等高利润、高附加值的产品亲写, 传统存储类别如 DDR4 的供应将面临紧张, 价值下游个人电脑及部分工业设备仍有需求, 将出现结构性供应失衡, 反推价格进一步上涨。铠侠目前的交期为 3-4 周, 处于分货状态, 原厂会优先满足大客户需求。

铠侠已确定在 2026 年量产其第 10 代 NAND 闪存。这款新产品的接口速度相比第 8 代提升了超过 30%, 旨在满足 AI 数据中心对高速存储快速增长的需求, 以期抢占市场先机。这一消息被市场视为重大利好, 是推动近期股价上涨的核心动力。另外, 铠侠 2025 年回减产 EMMC, 主要集中在 4G、8G 的小容量 EMMC。

TI 计划到 2030 年实现 95% 的自主生产

为提高半导体生产的自给自足能力, TI 设定了到 2030 年将其内部制造能力提高 95% 以上的目标。TI 邹舟、中东、非洲和硬度总裁 Stefan Bruder 表示, 公司正在多个地区投资建设工厂, 并采用双流生产模式, 以提

供地缘政治上可靠的产能。

自 2021 年以来, TI 将在美国德克萨斯州和犹他州的三大超级厂区投资超过 600 亿美元, 建设 7 座晶圆厂, 其中包括位于德克萨斯州谢尔曼市的新建 300 毫米晶圆厂, 投资额高达 400 亿美元。该公司表示, 这些项目加起来有望创造超过 6 万个就业岗位。TI 目前在全球 15 个制造基地中, 包括位于德克萨斯州理查森市和犹他州莱希市的 300 毫米晶圆厂。

中科微多领域需求远超预期, 多款型号涨价

ZKMicro 多款型号涨价。主要因为智能家居、工业传感器等领域的需求远超预期, 国产替代需求强烈。典型的 2.4GHz 无线 MCU 芯片 Si24R1、Si24R2 等型号第三季度起价格上涨约 15-20%; 北斗多模导航模块较年初涨了 12%; 显示驱动芯片如 AT7456E 价格上涨幅度 15-25%, 主要应用于国产车载中控屏跟工业相机等。订货交期相比之前延长 2-4 周, 紧缺物料要看原厂分货情况。

纳芯微车规物料交期依旧紧张

纳芯微目前订货交期整体呈现“车规紧、工业稳、消费松”的特点。车规级芯片当前交期压力最大, 像系统基础芯片、CAN FD 收发器这些核心物料的交期普遍在 12-16 周, 特别是适配 800V 高压平台的智能隔离驱动系列, 因为比亚迪、蔚来这些车企的订单集中, 交期甚至要 18 周以上。工业级产品相对好一些, 比如光伏和储能用的隔离采样芯片, 交期在 8-12 周, 标准品库存能支撑快速交付。消费类的温湿度传感器最稳定, 交期基本维持在 6-8 周, 部分型号还有现货。不过要注意, 他们刚推出的车规级新品, 比如带米勒钳位功能的隔离半桥驱动, 目前还在小批量阶段, 交期可能要 20 周左右。价格方面整体比较稳定, 没有大幅波动。

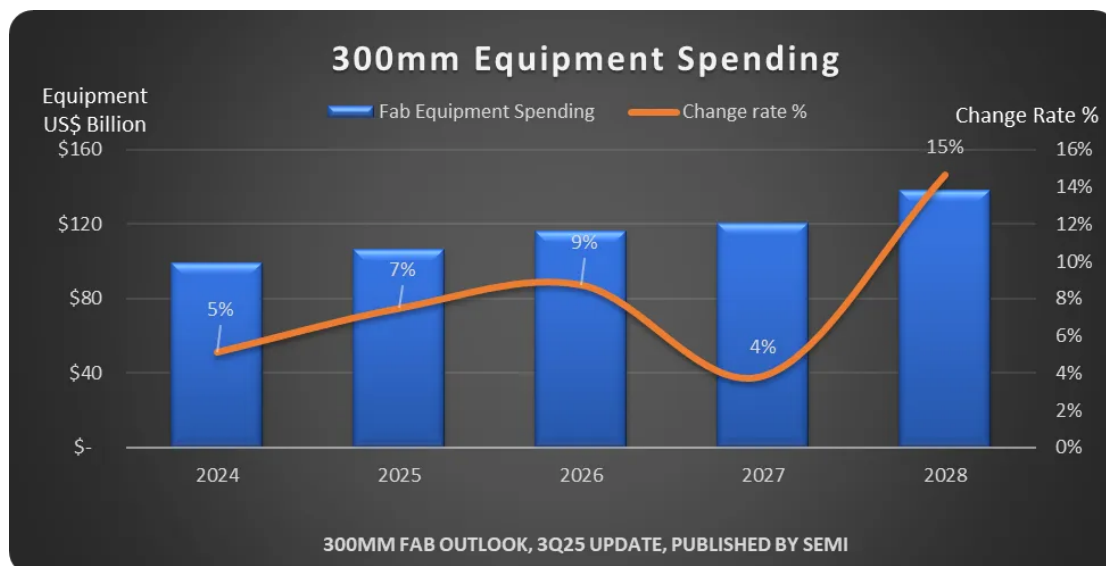
行业趋势

SEMI 报告称，未来三年全球 300 毫米晶圆厂设备支出预计总计将达 3740 亿美元

SEMI 在其最新发布的《300mm 晶圆厂展望》报告中指出，2026 年至 2028 年全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将达到 3740 亿美元。这一强劲的投资反映了晶圆厂区域化趋势以及数据中心和边缘设备对人工智能芯片的激增需求，同时也凸显了各主要地区通过本地化产业生态系统和供应链重组，日益重视实现半导体自给自足的决心。

预计到 2025 年，全球 300 毫米晶圆厂设备支出将首次突破 1000 亿美元大关，增长 7%至 1070 亿美元。报告预测，2026 年投资额将增长 9%至 1160 亿美元，2027 年增长 4%至 1200 亿美元，2028 年增长 15%至 1380 亿美元。

“半导体行业正步入一个关键的转型时代，这主要得益于对人工智能技术的空前需求以及对区域自给自足的重新重视，”SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示。“全球战略投资与合作正在推动稳健、先进的供应链，并加速下一代半导体制造技术的部署。300 毫米晶圆厂的全球扩张将促进数据中心、边缘设备和数字经济的发展。”



细分市场增长

预计逻辑与微器件领域将引领设备扩张，2026 年至 2028 年间总投资额将达到 1750 亿美元。晶圆代工厂预计将成为这一增长的主要驱动力，这主要得益于 2 纳米以下制程产能的提升。关键推动因素包括全环栅 (GAA)

架构和背面供电等先进技术，这些技术对于提升芯片性能和能效，以满足日益苛刻的人工智能工作负载需求至关重要。更先进的 1.4 纳米制程技术预计将在 2028 年至 2029 年间实现量产。此外，人工智能性能的提升预计将推动边缘设备（包括汽车电子、物联网应用和机器人）的蓬勃发展。除了先进制程之外，所有节点和各种电子设备的需求预计也将显著增长，从而推动成熟制程设备的投资。

预计未来三年内存领域的支出将达到 1360 亿美元，位居第二，标志着该领域新一轮增长周期的开始。2026 年至 2028 年，DRAM 相关设备投资预计将超过 790 亿美元，同期 3D NAND 投资将达到 560 亿美元。人工智能训练和推理推动了各类内存需求的全面增长。人工智能训练需要更高的数据传输带宽和极低的延迟，这显著提升了高带宽内存（HBM）的需求。此外，模型推理能够生成更高质量、更多样化的人工智能数字内容，从而对终端存储容量产生巨大需求，并推动了 3D NAND 闪存的需求。这种强劲的需求在中长期内维持了内存供应链的高投资水平，有助于缓解传统内存周期波动带来的潜在衰退。

预计未来三年模拟相关领域的投资将超过 410 亿美元。包括化合物半导体在内，电力相关领域预计在 2026 年至 2028 年期间将投资 270 亿美元。

区域增长

预计中国将继续引领 300 毫米装备支出，2026 年至 2028 年预计投资额达 940 亿美元，这得益于国家自主研发政策的支持。

预计未来三年，韩国在全球 300 毫米设备支出方面将位居第二，投资额达 860 亿美元，这将支持全球各行业对生成式人工智能的需求。

预计台湾将在未来三年内投资 750 亿美元用于 300 毫米制程设备，位居全球第三。投资将主要集中在 2 纳米及以下制程产能，以保持其在先进晶圆代工产能和技术领先地位。

报告预测，2026 年至 2028 年间，美洲地区的投资额将达到 600 亿美元，跃升至全球第四位。美国供应商正在扩大先进工艺产能，以满足人工智能应用领域激增的需求，同时也在推动国内产业和投资升级，以保持其在全球技术发展领域的领先地位。

预计未来三年，日本、欧洲及中东和东南亚将分别投资 320 亿美元、140 亿美元和 120 亿美元。旨在缓解关键半导体供应问题的政策激励措施预计将使这些地区的设备投资在 2028 年比 2024 年增长 60% 以上。

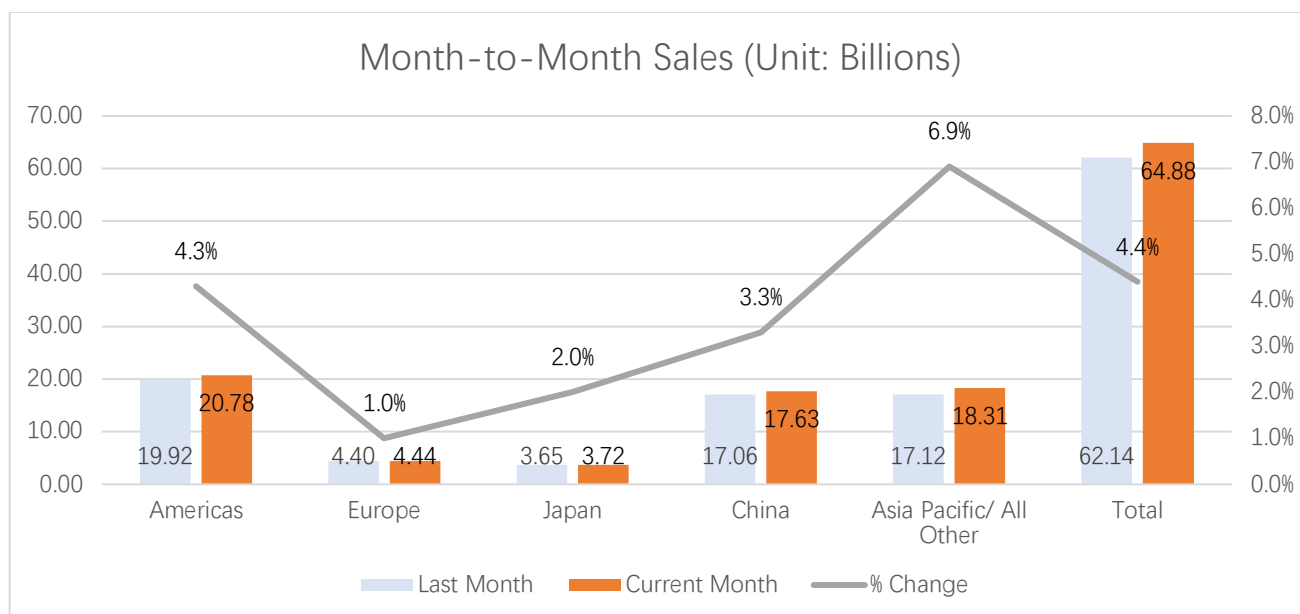
8 月份全球半导体销售额同比增长 21.7%。

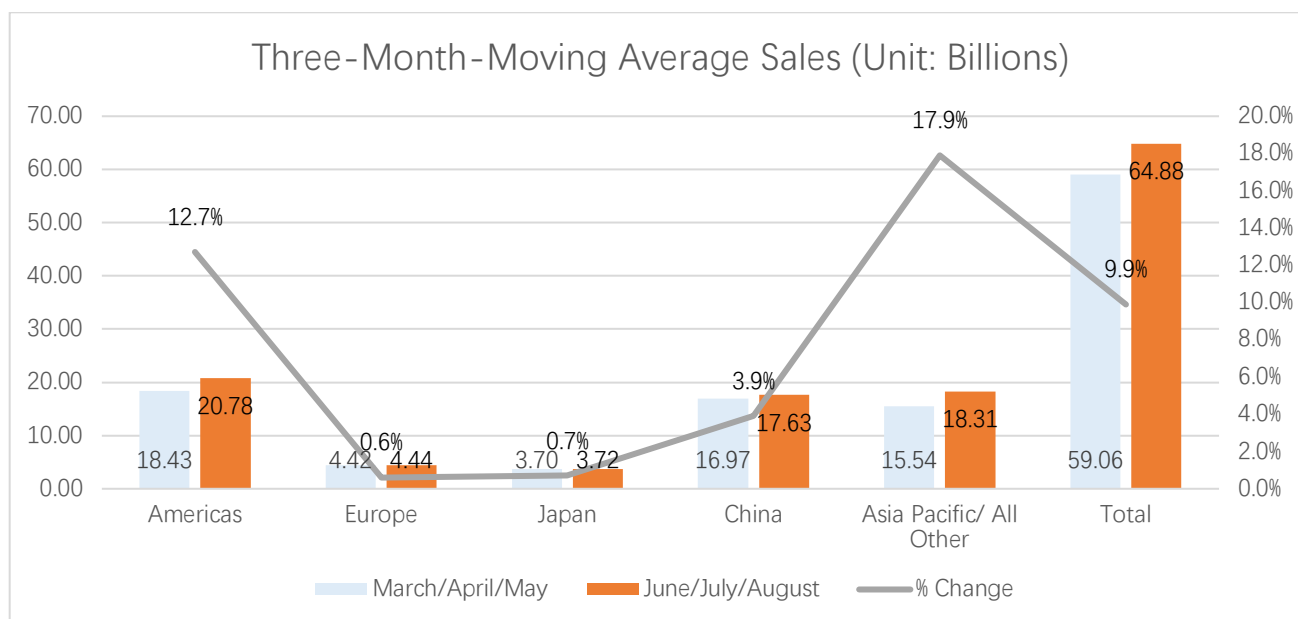
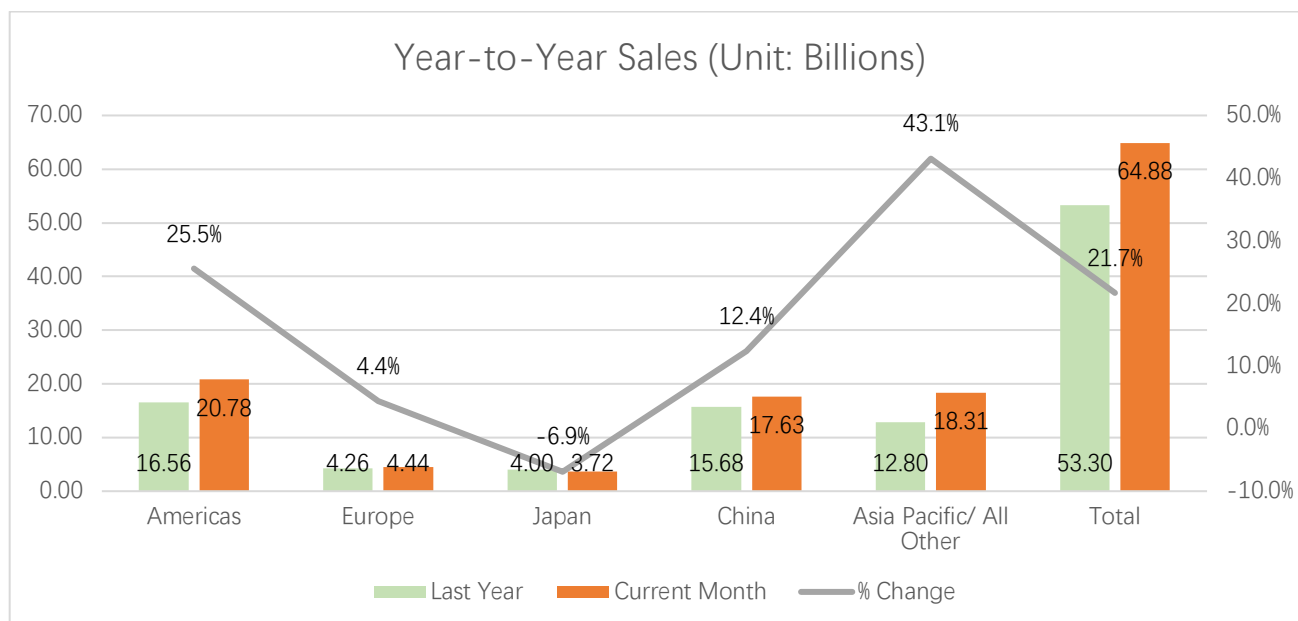
美国半导体行业协会（SIA）今日宣布，2025 年 8 月全球半导体销售额为 649 亿美元，较 2024 年 8 月的 533 亿美元增长 21.7%，较 2025 年 7 月的 621 亿美元增长 4.4%。月度销售额数据由世界半导体贸易统计

组织（WSTS）统计，并采用三个月移动平均值。SIA 的会员企业占美国半导体行业总收入的 99%，以及近三分之二的非美国芯片企业。

“8 月份全球半导体销售额继续增长，远超去年同期水平，”美国半导体行业协会（SIA）总裁兼首席执行官约翰·纽弗表示。“亚太地区 and 美洲地区的销售额继续推动增长，其中存储器和逻辑芯片的销售额增幅尤为显著。”

从区域来看，8 月份亚太及其他地区（43.1%）、美洲（25.5%）、中国（12.4%）和欧洲（4.4%）的销售额同比均有所增长，但日本的销售额则下降了 6.9%。8 月份亚太及其他地区（6.9%）、美洲（4.3%）、中国（3.3%）、日本（2.0%）和欧洲（1.0%）的销售额环比均有所增长。





安世专题报道

Nexperia 事件来龙去脉及后续影响

事件发展

2025-09-30 — 荷兰政府动用《货物可用法》(Goods Availability Act)，实际接管 Nexperia (临时干预)
荷兰经济事务部援引该法令对 Nexperia 实施干预，理由是公司治理存在严重问题、可能导致关键技术与能力外流。多家媒体与荷兰政府公告对此进行了报道。

2025-10-04 — 中国商务部（或有关部门）对 Nexperia 中国业务发出出口限制/管控通知
中国方面对 Nexperia 在华打包/出货环节实施出口管控（限制某些成品/子组件出境），导致国际客户的交付受影响。Nexperia 官方随后公开说明公司正与中方沟通寻求豁免。

2025-10-07 — Nexperia 高层/CEO 的管理权争议与临时停权
报道显示荷兰当局曾暂停 Nexperia 原任中国背景高管（报道指张某/CEO）参与管理，并指出有把欧洲研发/设备迁往中国的担忧。此事是荷兰采取干预措施的直接背景之一。

2025-10-14 — Nexperia 官方发布“公司事态更新”声明（说明与各国政府沟通）
Nexperia 在其官网发布公开声明，说明 10 月初以来中荷双方及其他相关政府措施、并表示正在与相关当局密切对话以降低对客户供应的影响。

2025-10-31 — Nexperia (荷兰总部) 暂停向中国组装/封装厂供应部分晶圆/原料 → 导致中国工厂出货中断

路透等媒体披露了一封发给客户的信，显示 Nexperia 荷兰总部已暂停向其中国封装/组装工厂运送晶圆或关键物料，制造与出货出现上游中断风险，引发全球整车厂担忧（因这类基础芯片广泛用于汽车电子）。

2025-10-31 ~ 2025-11-01 — 外交/贸易层面急速交涉；中国表态考虑对部分出货给予豁免
在事态扩大、车厂预警后，中国商务部/相关部门表示可以考虑对受影响出货给予豁免许可（企业/客户可申请），以缓解全球供应链压力；同时有消息称美中领导人会谈也包含相关协调内容。

2025-10-31 / 2025-11-01 — 美国与有关各方介入；有消息称美方将宣布允许 Nexperia 在中国的设施恢复对外出货（或促成豁免）

多家媒体援引消息人士称，美中在高层会谈中就此事达成某种安排，允许在特定条件下恢复对外出货，从而避免对汽车产业造成更大冲击。（报道有时间点和细节差异，后续演变仍有不确定性。）

2025-11-02 — Nexperia 荷兰总部公开欢迎有关放宽限制/恢复出货的公告，但对细节保持谨慎
荷兰总部表示欢迎中美等方就恢复供应所作的声明/进展，同时强调当前重点是保证客户供应稳定，并称不

会对中国子公司具体运作细节进行评论。

2025-11-04 — 路透独家：Nexperia 向客户的信件显示仍“不确定是否/何时”中国单位会恢复对外出货。路透获得的内部 / 给客户的信显示，尽管有政府层面声明与豁免机制，但 Nexperia 也明确表示对中国单位何时能恢复对外出货仍不确定，短期内交付仍有风险（供应恢复存在程序性/许可审批等障碍）。

中方应对措施

1) 出口管制的精准打击

安世半导体的全球生产链存在一个致命弱点：其前晶圆制造虽分布欧洲，但高产量、低成本的后端封装测试则严重依赖其中在中国境内的工厂，有文件明确指出，中国东莞占据了按时全球封测约 70% 的产能。这种前欧后中的分工结构，在政治冲突中构成了安世荷兰实体的巨大运营缺陷。中国商务部发出的出口管制通知，直接禁止了安世及其分包商出口在中国境内制造的特定成品元器件和子组件，这也直接导致了欧洲晶圆厂生产的晶圆无法高效、大规模地转化为销往全球市场的成品。

2) 安世中国的独立宣言

面对荷兰总部单方面免职中方高管的决定，安世半导体中国公司迅速发表声明，强调该决定在中国境内不具备法律效力，并指示团队继续独立运营。这一行动标志着闻泰科技完成了对安世核心平台的战略性去核。闻泰科技利用对高产量生产资产的实际控制权，迅速将安世中国定位为新的、有保障的供应商，从而在功能上实现了核心供应链的本土化和风险隔离。

3) 地缘政治杠杆的组合拳

此外，中方还将钬、铽等重稀土纳入出口配额管理，此举是针对全球半导体产业依赖中国稀土供应的组合拳。这记在材料端和制造后端的双重打击，使得荷兰政府迅速服软，其经济大臣卡雷曼斯公开承认低估了中方韧性，紧急寻求对话。这有力证明了地缘政治的筹码，已从单纯的法律和技术上游，转移到了对供应链关键环节（材料和后端制造）的实际控制方。

后续可能产生的影响——欧洲汽车工业受到严重影响

安世半导体是全球车规级功率半导体前三强，控制着全球约 40% 的基本半导体元件市场（包括二极管、晶体管、MOSFET 等）。这些分立元件是大众、宝马、奔驰等欧洲一线汽车品牌车辆电子控制单元（ECU）等关键系统所必需的基础组件。欧洲汽车制造商协会（ACEA）紧急警告，争议若无法迅速解决，欧洲汽车产业链将面临至少 3 个月的中断。

引用大众汽车集团首席执行官奥利弗·布鲁姆的话说，公司目前芯片库存充足。然而，中国对耐普瑞亚（Nexperia）产品实施的出口禁令，引发了欧洲汽车制造商争夺剩余芯片供应的狂潮。

通用汽车首席执行官玛丽·博拉警告称，芯片限制“可能会影响生产”，并补充说，团队正在“与供应链合作伙

伴夜以继日地工作，以最大限度地减少中断”，她称目前的形势“极不稳定”。

对于汽车制造商而言，更换关键零部件需要漫长而严格的测试和认证过程（通常需要 12-36 个月，以满足 AEC-Q101 和 IATF 16949 等标准）。安世在分立元件市场 40% 的份额，在短期内无法被其他供应商（如安森美、英飞凌等）迅速吸收。

这充分揭示了全球产业链的深度融合和脆弱性，政治干预的成本最终将由全球消费者和产业工人承担。

政策影响

墨西哥关税可能削弱美国制造业和供应链韧性

全球电子协会敦促政策制定者保护北美贸易和近岸外包的成果，因为 30% 的关税即将迎来关键决策期限。随着美墨贸易政策谈判临近 10 月 29 日最后期限，全球电子协会今日发布了一份新的政策简报《从风险到韧性：墨西哥对美国制造业的重要性》。该报告警告称，拟议对墨西哥电子产品进口征收 30% 的关税将破坏北美供应链，增加美国制造商的成本，并削弱美国将生产迁回国内、增强国内竞争力的努力。

该报告由协会首席经济学家肖恩·杜布拉瓦克和行业情报团队撰写，结论是墨西哥已发展成为北美生态系统中一个成熟的生产中心，并依托多元化的全球供应商网络。数据显示，自 2017 年以来，墨西哥从中国的进口量显著下降，采购来源转向越南、韩国、台湾和欧盟。

“如今，电子制造业依赖于跨境合作，”全球电子协会墨西哥办事处主任洛雷娜·维拉纽瓦表示，“墨西哥已成为加强北美制造业的重要合作伙伴。我们的供应链不是竞争对手，而是合作伙伴。承认这种伙伴关系的政策将确保两国在瞬息万变的全球市场中保持竞争力。”

该协会强调，维持与墨西哥的牢固贸易伙伴关系是美墨两国制造商的首要任务。许多会员企业表示，美墨贸易是他们最关注的政策议题。

该报告的发布正值关键时刻：美墨贸易谈判的延期将于 10 月 29 日到期，而美国贸易代表办公室（USTR）正在就《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）接受公众意见，截止日期为 11 月 3 日。全球电子协会将代表业界提交正式意见，并计划于 11 月 17 日在美国贸易代表办公室的公开听证会上作证。

全球电子协会全球政府关系副总裁克里斯·米切尔表示：“美墨贸易不仅重要，而且对北美电子生态系统的韧性至关重要。促进美国制造业发展和支持墨西哥工业增长是同一枚硬币的两面。”

报告强调，许多电子系统和零部件在最终组装前会多次跨境穿越美墨边境，这反映出深度整合的供应链支撑着整个地区的竞争力、就业和安全。通过关税扰乱这些供应链流动将推高成本、延长交货时间，并威胁到中小制造商的生存。

该协会敦促政策制定者尽快敲定双边贸易协定，以维持免关税准入、加强执法，并巩固墨西哥作为北美制造业韧性共同建设者的作用。

报告总结道：“墨西哥制造业的发展是近岸外包成功案例中最明显的例证之一。保护这一成果对于该地区的经济稳定和构建真正具有韧性的供应链至关重要。”

最新财报

德州仪器 (TI)

总体表现

- 营收47.42 亿美元，同比增长 14%，环比增长 7%，超出市场预期的 46.5 亿美元； 1
- 净利润16.63 亿美元，同比增长 7%；

核心业务表现

- 模拟芯片业务（占营收 77.5%）延续增长态势，同比增长 16%至 37.29 亿美元，营业利润同比增长 13%至 14.86 亿美元，得益于工业自动化、电动汽车及 AI 基础设施需求回暖；
- 嵌入式处理业务营收同比增长 9%至 7.09 亿美元，营业利润同比下滑 1%至 1.08 亿美元，在工业控制、汽车电子等领域保持竞争力，但面临瑞萨、英飞凌等厂商竞争。

未来展望

- 公司预计 2025 年第四季度营收为 44.5 亿 -48 亿美元，中值 26.25 亿美元。管理层提示，客户对模拟芯片需求增速可能低于预期，且关税政策导致的提前采购效应可能影响未来订单。

恩智浦 (NXP)

总体表现

- 第三季度总营收达 38.2 亿美元，同比大幅增长 12%，环比增长 5%，远超平均预测的 36.8 亿美元。
- 盈利能力持续提升，毛利率攀升至 58.7%，同比提升 1.9 个百分点；净利润达 8.5 亿美元，同比增长 22%。

核心业务表现

- 汽车电子业务营收突破 21 亿美元，同比增长 18%，占总营收 55%，成为最大增长引擎。恩智浦 S32G 车载网络处理器系列出货量同比增长 40%，已被全球超 30 家主流车企应用于下一代电子电气架构
- 工业自动化领域营收同比增长 25%，边缘 AI 处理器 i.MX 9 系列在智能工厂场景渗透率快速提升，季度出货量突破 3000 万片。
- 5G 基站射频芯片出货量环比增长 18%，Wi-Fi 7 解决方案在小米、荣耀旗舰机型实现大规模商用。

未来展望

- 研发投入强度达 21%: 季度研发支出突破 8 亿美元，重点投向车规级 5nm 工艺、神经处理单元(NPU) 架构优化、量子安全加密芯片等前沿领域。

- 生态合作纵深拓展：与台积电共建汽车芯片专属产线；同微软 Azure 合作开发工业 AI 云边协同平台；开源 S32DS 开发工具链，吸引全球超 10 万开发者参与生态建设。
- 产能布局未雨绸缪：新加坡 12 英寸晶圆厂扩建项目提前投产，德州奥斯汀工厂获美国 CHIPS 法案 28 亿美元补贴，车规级芯片产能预计 2026 年提升 40%。

三星 (Samsung)

总体表现

- 总营收：86.06 万亿韩元（约 606 亿美元）
↳ 同比 +8.8%，环比 +15.4%
- 营业利润：12.16 万亿韩元（约 85.6 亿美元）
↳ 同比 +32.2%，远超预期（10.1 万亿韩元）
- 净利润：12.22 万亿韩元（约 86 亿美元）
↳ 同比 +21%

核心业务表现

1) DS 部门 (Device Solutions)

包括存储、系统 LSI、晶圆代工等核心半导体业务

- 营收：33.1 万亿韩元（约 233 亿美元）
- 营业利润：7.0 万亿韩元（约 49 亿美元）
- 存储业务：
 - 受 HBM3E 与服务器 SSD 需求强劲带动，销售环比 +26%，创历史新高。
 - HBM3E 已量产并供应所有主要客户，HBM4 样品正在出货。
 - 预计 Q4 将继续扩大 DDR5、GDDR7、eSSD 等 AI 存储产品出货。
 - 2026 年目标：量产 HBM4、扩大 1c DRAM 与高密度产品产能。
- 系统 LSI 业务：
 - 受季节性与客户去库存影响，业绩持平。
 - Q4 计划强化高端 SoC 与影像传感器销售。
 - 2026 年重点：强化 Exynos 在旗舰机中的竞争力。
- 晶圆代工业务：
 - 利润大幅改善，创下客户订单纪录。
 - Q4 将量产 2nm GAA 节点。

- 2026 年：美国德州 Taylor 厂计划投入运营，重点供应 HBM4 基础芯片。

2) DX 部门 (Device eXperience)

包括智能手机、可穿戴设备、电视、家电等终端业务

- 营收：48.4 万亿韩元，同比 +8%，环比 +11%。

移动体验 (MX) 与网络部门

- 营收：34.1 万亿韩元 (约 240 亿美元)
- 营业利润：3.6 万亿韩元 (约 25 亿美元)
- Galaxy Z Fold7 销售强劲，平板与穿戴设备恢复增长。
- Q4 将主推 AI 手机 Galaxy S25 系列。
- 2026 年：通过折叠形态创新与 AI 功能强化产品差异化。

视觉显示 (VD) 与家电

- 营收：13.9 万亿韩元 (约 98 亿美元)，营业亏损 0.1 万亿韩元。
- 高端 OLED、Neo QLED 销售良好但竞争激烈压缩利润。
- Q4 重点：大屏电视、AI 功能电视、Micro RGB 创新产品。

3) SDC (三星显示)

- 营收：8.1 万亿韩元 (约 57 亿美元)
- 营业利润：1.2 万亿韩元 (约 8.4 亿美元)
- 中小尺寸显示增长显著，受旗舰智能手机拉动。
- 大尺寸显示器销量增长，受游戏显示器需求带动。
- 未来将扩大 QD-OLED 系列，布局 8.6G IT OLED 产线。

未来展望

- AI 是核心增长驱动：HBM、DDR5、GDDR7 等高附加值产品持续放量。
- 先进制程突破：2nm GAA 将于 Q4 量产，强化代工竞争力。
- 终端与显示业务聚焦高端化与 AI 集成。
- 目标：2026 年巩固全球半导体与显示领导地位，并扩大 AI 应用生态。

SK 海力士 (SK Hynix)

总体表现

- 营收 24.45 万亿韩元 (同比+39%，略低于预期的 24.73 万亿韩元)。
- 营业利润 11.38 万亿韩元 (同比+62%，首次突破 10 万亿大关)。

- 净利润 12.59 万亿韩元（同比+119%）。

业绩驱动因素

- 12 层 HBM3E 芯片和 DDR5 服务器内存销量激增，AI 服务器需求带动 128GB 以上大容量 DRAM 出货量环比翻倍。
- 企业级 SSD 产品溢价显著提升 NAND 业务利润率。

未来展望

- 9 月完成 HBM4 开发并投入量产，计划 2026 年全面扩大销售。
- 当前 HBM 市场份额达 62-64%，领先三星（17%）和美光（21%）。
- 2026 年全部 DRAM/NAND 产能已被预订。
- 第四季度启动 HBM4 供应，预计 2026 年 DRAM 出货量增长超 20%。
- 通过 M15X 项目扩大产能应对持续至 2027 年的供应紧张

英特尔 (Intel)

总体表现

- 核心数据：2025 Q3 营收 137 亿美元（同比+3%），非 GAAP 每股收益 0.23 美元。
- 盈利突破：结束连续 6 个季度亏损，净利润达 41 亿美元，毛利率提升至 38.2%。

业绩驱动因素

- 战略调整：出售 Altera 芯片业务完成剥离，获得美国政府 90 亿美元注资及英伟达 50 亿美元投资。
- 业务增长：数据中心与 AI 部门收入同比增长 12%，客户端计算业务增长 5%。
- 成本管控：通过裁员和工厂优化节约 28 亿美元运营成本。

未来展望

- Q4 指引：预计营收 128-138 亿美元（不含 Altera 业务），非 GAAP 每股收益 0.08 美元。
- AI 布局：重点发展 x86 平台、ASIC 芯片和晶圆代工服务，承接美国芯片法案战略项目。

高风险物料预警

Part Number	Manufacturer
BLL1214-35	NXP SEMICONDUCTORS
EPM7256SQC208-15N	ALTERA CORP
PSM1-402Z-10T0	SPECTRUM CONTROL INC
M83446/05-58F	VANGUARD ELECTRONICS
DD89N12K-K	EUPEC GMBH & CO KG
R596812100	RADIALL S A
XC2S150-5FG256I	XILINX INC
CY7C343B-35JI	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP

注：该部分数据来源于 ERAI，仅供参考。